

天岳先進 (2631)

開始認購日期	2025 年 8 月 11 日
截止認購日期	2025 年 8 月 14 日上午
公開發售結果	2025 年 8 月 18 日
上市日期	2025 年 8 月 19 日
保薦人	中信證券、中金公司

集團概要:	
公開發售價	\$42.8 元
市值	\$30,295 百萬港元
行業	半導體材料
全球發行股數	47,745,700
集資總額	\$2,043.6 百萬(HK\$42.8 計算)
香港發售股份佔比	5%
每手入場費	\$4,323.17 元

集團簡介:
集團深耕寬禁帶半導體材料行業，專業技術實力雄厚，自成立以來即專注於碳化硅襯底的研發與產業化。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2024 年碳化硅襯底的銷售收入計，集團是全球排名前三的碳化硅襯底製造商，市場份額為 16.7%。集團的碳化硅材料為新能源與 AI 兩大產業提供核心支撐，驅動未來科技進步。集團的碳化硅襯底可廣泛應用於電動汽車、AI 數據中心、光伏系統、AI 眼鏡、軌道交通、電網、家電及先進通信基站等領域。

行業現況
從 2020 年到 2024 年，碳化硅功率半導體器件市場顯著增長。全球碳化硅功率半導體器件在全球功率半導體器件市場中的滲透率由 1.4%增至 6.5%，預計於 2030 年將達到 22.6%。該等增長主要歸因於碳化硅器件在各個行業日益廣泛的採用，尤其是在 xEV 及光伏行業。在 xEV 領域，碳化硅功率半導體對提升電動汽車的性能至關重要，包括增加行駛里程、實現更快的充電速度及提高動力總成效率。向太陽能、風能等可再生能源系統的轉型，亦推動了逆變器及電網基礎設施對碳化硅元件的需求。

經國農證券認購截止日期

2025 年 8 月 14 日 4pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

行業風險

集團可能無法以具成本效益的方式優化生產流程及大量生產的能力。在開始大量生產集團推出的新產品時，集團也可能面臨製造良品率較低及交付時間較長的問題，這可能會增加集團的成本，並擾亂該等產品的供應。此外，倘新型或改良型產品的初始銷量未在集團預期的時間內達到預期水平，集團可能需要進行額外的營銷工作來推廣該等產品，則開發及商業化該等產品的成本可能會高於集團的預測。倘集團未能及時開發新產品，或以具成本效益的方式迅速獲得市場認可，集團的經營業績可能會受到重大不利影響。

主要財務數據：

(人民幣千元)	2023	2024
收入	1,250,696	1,768,141
銷售成本	(1,068,660)	(1,332,688)
毛利	182,036	435,453
除稅前溢利	(56,159)	159,264
淨溢利	(45,720)	179,025

集資用途	(百分比)
用於擴張 8 英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能	70%
用於加強研發能力，保持創新領先地位	20%

主要股東	
股東名稱	持股百分比(%)
宗艷民	27.08%